

2023年9月11日

各 位

会 社 名：ウインテスト株式会社
(コード：6721 東証スタンダード市場)
代表者名：代表取締役社長 姜 輝
問合せ先：専務取締役 樋口 真康
(TEL：045-317-7888)

「(再訂正) 資金使途の変更に関するお知らせ」の一部再訂正について

当社は、2023年8月4日付「資金使途変更に関するお知らせ」及び2023年8月7日付「(訂正) 「資金使途の変更についてのお知らせ」の一部訂正について」で開示いたしました記載事項の一部に再訂正すべき事項があり、2023年9月11日にあらためて取締役会決議を行いましたのでお知らせいたします。

記

1. 訂正の理由

下記<訂正後>に記載いたしました理由により、2023年9月11日付「第2四半期報告書の訂正報告書」を提出したため、資金使途の内容につきまして変更を行うものであります。

当社は、半導体部材仕入れ、次世代装置の開発並びに技術者の増員と製造工場の移転、その他運転資金への充当で498,114,000円の調達を予定しておりました。しかしながら、当初想定していなかった、当社中国の100%製造子会社偉恩測試技術(武漢)有限公司(以下「製造子会社」または「ウインテスト武漢」という)に対する貸付の必要性が、調達期間中に発生いたしました。また、当社における資金使途の充当状況に関して、第1四半期中にGFA株式会社より2022年に資金の借入があったものを自己資金で返済としており資金使途の範囲に含まれないと判断しておりました支出について、改めて当社内において検証し、その返済の一部は、資金使途からの充当として取扱うべきと判断したため、訂正することとしました。また、同期間中に当社の株価変動が影響し、行使完了までの本新株予約権の行使価額が修正され、当初予定していた調達予定額を下回りました。そのため、「第三者割当による第11回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ」当初資金使途を変更することとし、2023年8月4日付「資金使途変更に関するお知らせ」及び2023年8月7日付「(訂正) 「資金使途の変更についてのお知らせ」の一部訂正について」を開示いたしました。あらためて資金使途の再訂正を行うとともに、使途変更に関わる説明が不十分であり、株主の皆様を始め、関係者の皆様に深くお詫びいたしますとともに、あらためて詳細を下記にてお知らせいたします。

●資金使途の具体的な変更理由

<装置製造に関わる半導体部材仕入れ等>

本仕入れ(先行発注)に関しましては、2023年2月以降、ひっ迫していた部材の需給バランスが緩和の方向に向かったこと、また第2四半期までの当社業績から装置製造台数を見直したことから先行発注の減少を3月末の時点で決定いたしました。

<次世代先端システム研究開発費>

次世代検査装置 WTS-9000 の開発に関し、バージョン 1 とバージョン 2 に分けてバージョン 1 を先行で開発する方向に舵を切りました。3月中旬から事実上のコロナ規制緩和が引き金となり、それまで渡航がかなわなかった中国や台湾への顧客訪問が可能となり、お客様の声をお聞きする中で、次世代システム WTS-9000 の開発には時間が必要ですが、それまでに既存装置の機能向上を望む声が多く、開発フェーズを分けることでお客様のご要望に応えることが可能となるとの判断で、フェーズを分け WTS-9000 用に開発完成している、次世代機能部品の一部を既存の現行装置に搭載、WTS-577 SX として完成させお客様に次世代装置の一部を早期に提供することとし、これをバージョン 1 とすることといたしました。そのため、バージョン 1 は 2023 年 9 月までに完成させ 10 月より出荷開始とし、引続き 2023 年末まで開発は継続しますが、バージョン 1 としたことで開発予算を見直しました。

<技術者増強（技術営業、開発、サポート）>

エンジニアの増強は当社の開発スピードアップ、そして技術営業方面でも重要ではありましたが、当社、業界関連エンジニアの採用は人材不足にも拍車がかかりつつあり、難航したため、用に代えて、優秀な派遣技術者の方々若干名を採用することに方針を変更いたしました。そのため、予算も見直しを行いました。

<製造工場移転増強>

工場移転増強は、特に大阪事業所を指しますが、工場ビルの契約期間の関係で、2024 年 3 月から計画を立て、2025 年末までに完了をする予定でしたが、株価の変動が想定以上に大きく想定調達額を下回りましたので、改めて今夏再検討を行い、中止といたしました。

<製造子会社への貸付（拠点移転費用、資材購入、運転資金）>

製造子会社への貸付については、中国における顧客サポートの多様化への対応と、顧客要求への即応性ニーズが今後の当社事業へ重要になると判断いたしました。当社グループ業績の低迷から当社 100%子会社であるウインテスト武漢の人員費が足りなくなり、当社子会社へ、貸付を行なうことといたしました。既に第 1 四半期連結会計期間にて貸付を行っておりましたが、追加での資金需要が見込まれることから合計額を 70 百万円としました。8 月 4 日に「資金使途の変更についてのお知らせ」中でお知らせした貸付額を 120 百万円としておりました。これは複数回の貸付に分かれており（1 月、3 月、7 月）、資金調達期間中であったことから 1 月の貸付分についても調達資金からの充当の誤解が発生しました。これは、今回調達資金専用口座を設けなかったことで経理部門と開示部門間の情報交換時に行き違いが発生したことが原因です。実際には、当社自己資金で賄っておりますので、調達した充当資金使途に入れるべきではありませんでしたので、修正し、貸付充当合計額を正しく 70 百万円とし訂正いたしました。

<GFA 株式会社への借入金の返済>

同社から運転資金を目的として、借入をしておりました。借入金の返済は、当初自己資金で返済をする処理を行う予定でおりました。実際には、調達資金の一部充当と自己資金で本年 2 月に複数回に分けて返済を行いましたが、調達資金専用口座を設けなかったことで、全額自己資金で返済したとの誤った認識をしていたため、2023 年 8 月 4 日の「資金使途の変更についてのお知らせ」には記載をしておりませんでした。あらためて、再訂正を行いました。

<その他当社運転資金>

変更のお知らせが訂正になった主な原因は、2022年下期から顕在化した民生半導体のだぶつきを背景に半導体製造各社は生産調整に入り、新規投資の見送りが発生、当社業績も低迷するなか、円安、エネルギー高騰が激しさを増してきたことから、想定以上の諸物価の高騰に対応する目的で、主に横浜本社と大阪事業所の経費等に急遽充当を決めましたが、それらの経理処理を行う際、増資規模が小さかったため調達資金口座を分けていなかったことが混乱を招きました。今後は増資規模に限らず口座管理を徹底し、再発防止に努めます。

2. 訂正の箇所および内容訂正箇所には網掛けを付しております。

<訂正前>

(変更前)

| | 具体的な使途 | 金額 (円) | 充当予定時期 |
|---|------------------------|-------------|------------------|
| ① | 装置製造に関わる半導体部材仕入れ等 | 130,000,000 | 2023年1月～2023年10月 |
| ② | 次世代先端システム開発費、バリエーション展開 | 100,000,000 | 2023年1月～2023年12月 |
| ③ | 技術者増強(技術営業、開発、サポート) | 100,000,000 | 2023年3月～2024年12月 |
| ④ | 製造工場移転増強 | 70,000,000 | 2024年3月～2025年12月 |
| ⑤ | その他運転資金 | 98,114,000 | 2023年1月～2024年12月 |

(変更後)

| | 具体的な使途 | 金額 (円) | 充当予定時期 |
|---|---|--------------|------------------|
| ① | 装置製造に関わる半導体部材仕入れ等 | 70,000,000 | 2023年1月～2023年12月 |
| ② | 次世代先端システム研究開発費 バージョン1 | 30,000,000 | 2023年1月～2023年8月 |
| ③ | 技術者増強(技術営業、開発、サポート) | 70,000,000 | 2023年1月～2023年8月 |
| ④ | 当社100%子会社(ウインテスト武漢)への一括貸付(拠点移転費用、資材購入、運転資金) | 120,000,000 | 2023年8月 |
| ⑤ | その他当社運転資金 | 140,088,200 | 2023年1月～2023年8月 |
| | 合計 | ¥430,088,200 | |

(変更前) ①で予定していた装置製造に関わる部材仕入れは、2023年上半期までの市場低迷が大きく響き、新規受注が低迷したため、製造部材在庫を見直し、減少させております。(変更前) ②次世代先端システム開発関連は一部を前倒しし、バージョン1(※注参照)とバージョン2(※注参照)に分け、今期はバージョン1のみに集中する戦略を取り予算の縮小をします。なお、(変更前) ③で計画していた開発・サポート技術者の増強に関し、変更後は、規模を縮小し、若干名を補充することとどめ、引続き、2024年度以降の予算で行うこととしております。(変更前) ④で計画していた、大阪工場の移転につきましては、調達予定資金が予定金額に届かなかったことで、今回の増資資金では移転が難しいと判断、2024年以降に再度計画することとし、延期といたしました。しかし、中国における顧客サポートの多様化への対応と、顧客要求への即応性ニーズが今後の当社事業へ重要になると判断し、当社100%子会社であるウインテスト武漢の営業・サポート拠点の移転並びに、武漢工場における新規開発装置向け部材の購入他で、当社子会社への貸付を行います。(変更前) ⑤の運転資金に関しましては、想定以上の諸物価の高騰などの影響を受けて(変更後) ⑤のように増加することとなりました。

※注 バージョン1 次世代信号発生器を完成させ、既存筐体に組み込み機能をアップさせたもの
バージョン2 次世代信号発生器並びに信号取り込み、筐体すべてが新開発品となる装置

<訂正後>

(変更前)

| | 具体的な用途 | 金額 (円) | 充当予定時期 |
|---|------------------------|-------------|------------------|
| ① | 装置製造に関わる半導体部材仕入れ等 | 130,000,000 | 2023年1月～2023年10月 |
| ② | 次世代先端システム開発費、バリエーション展開 | 100,000,000 | 2023年1月～2023年12月 |
| ③ | 技術者増強(技術営業、開発、サポート) | 100,000,000 | 2023年3月～2024年12月 |
| ④ | 製造工場移転増強 | 70,000,000 | 2024年3月～2025年12月 |
| ⑤ | その他運転資金 | 98,114,000 | 2023年1月～2024年12月 |

(変更後)

| | 具体的な用途 | 金額 (円) | 支出予定時期 |
|---|---|-------------|--------------------|
| ① | 装置製造に関わる半導体部材仕入れ等 | 66,000,000 | 2023年2月～2023年12月 |
| ② | 次世代先端システム研究開発費 Ver. 1 | 30,000,000 | 2023年2月～2023年12月 |
| ③ | 技術者増強 (技術営業、開発、サポート) | 70,000,000 | 2023年2月～2023年8月 |
| ④ | 製造工場移転増強 | — | 中止 |
| ⑤ | 当社100%子会社ウインテスト武漢への貸付 (拠点移転費用、資材購入、運転資金) | 70,000,000 | 2023年3月 2023年7月 |
| ⑥ | GFA株式会社への返済 | 47,000,000 | 2023年2月 |
| ⑦ | その他当社運転資金 | 147,088,200 | 2023年2月～2023年8月 |
| | 合計 | 430,088,200 | |

以上